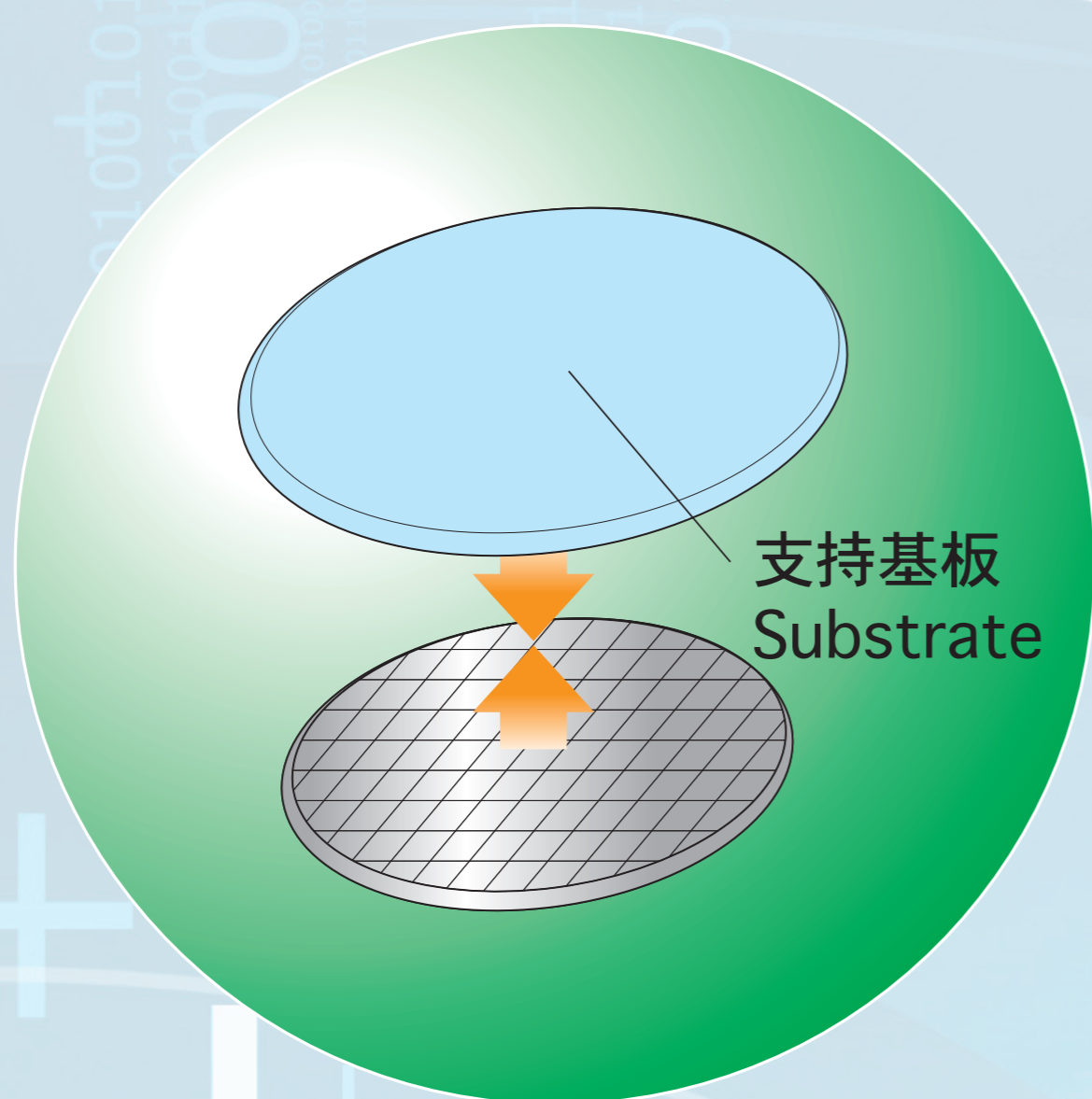


GWSM-300M

ウェーハ / 支持基板貼付装置 WAFER/SUBSTRATE ATTACHING MACHINE

【概要 - Outline -】

◆本装置は、B/G工程の前装置としてウェーハ薄厚化に対応する為、予め特殊両面テープが貼付けられたウェーハと支持基板を真空状態内において貼り合わせを行う装置である。
This machine is designed to laminate a thin wafer laminated with special two-sided tape with a substrate in a vacuum chamber as a front end equipment in the wafer back-grinding process.



仕様 Specification	GWSM-300M
スループット Throughput	約 30 枚 /h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)
対応ウェーハサイズ Wafer Size	12 inch
装置寸法 Demension	W 700 × D 1,200 × H 1,600 mm
重量 Weight	約 300 kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.